



# 2023年3月期 第3四半期 決算説明資料

東証スタンダード 証券コード：6614  
2023年2月10日

## 売上高および各利益とも計画以上の進捗

- 今第3四半期（累計）は期初予想を上回る進捗。  
当社の売上・利益は第4四半期に集中する傾向があるが、今期は顧客の調達強化により、一部第3四半期への前倒しもあり進捗率は順調な推移を維持。
- 売上高は、活況な市況に加え、材料納期遅延の影響を最小限に抑え前期比でも増収。
- 経常利益は、増収効果、高付加価値製品への取り組み、適正な価格転嫁により、3Q計画比及び前期比でも増益。  
下期のウェイトが高いが、3Qへの前倒しもあり、通期での進捗は124.2%と順調。（対前年+90.5%）
- 受注は引き続き堅調であり、部品の長納期化は残るものの、価格高騰の影響はある程度価格転嫁できており、通期業績見通しを上方修正する。

(単位：百万円、%)

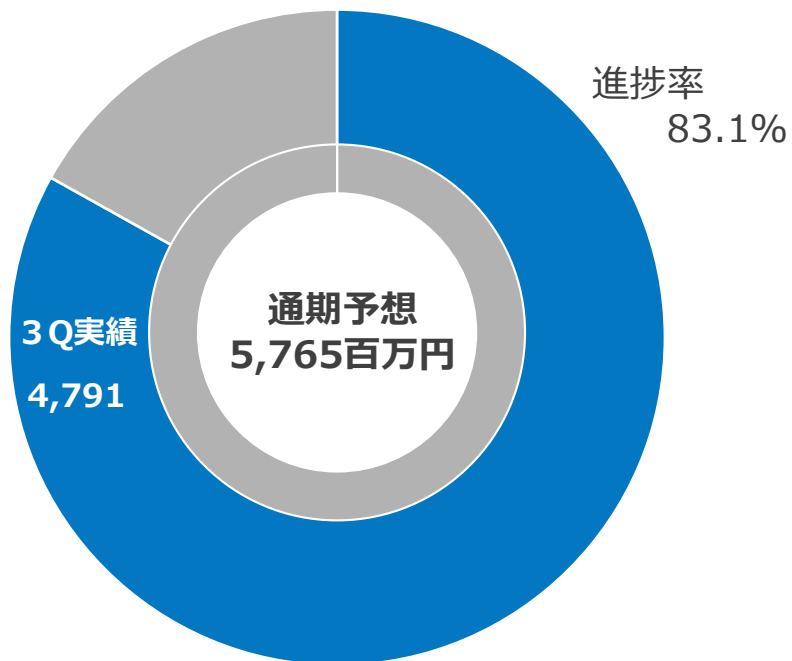
第3四半期累計	2023/3月期 通期予想 (当初)	2023/3月期 3Q実績 (累計)	通期予想比 (進捗率)	2022/3月期 3Q実績 (累計)	対前年増減率
売上高	5,765	4,791	83.1	3,839	24.8
営業利益	410	529	128.9	266	98.4
経常利益	433	537	124.2	282	90.5
当期純利益	337	367	108.8	179	104.6

通期	2023/3月期 通期予想 (当初)	2023/3月期 業績予想 (2/10修正)	当初予想比 増加率	2022/3月期 通期実績 (累計)	対前年増減率
売上高	5,765	6,450	11.9	5,359	20.4
営業利益	410	590	43.7	396	48.8
経常利益	433	600	38.5	416	44.0
当期純利益	337	440	30.6	327	34.4

通期予想に対する進捗率 : 売上高83.1% 経常利益124.2% 予想に対して順調な進捗。  
【参考】前期3Q時点の進捗率 : 売上高75.3% 経常利益98.6% 前期比においても順調。

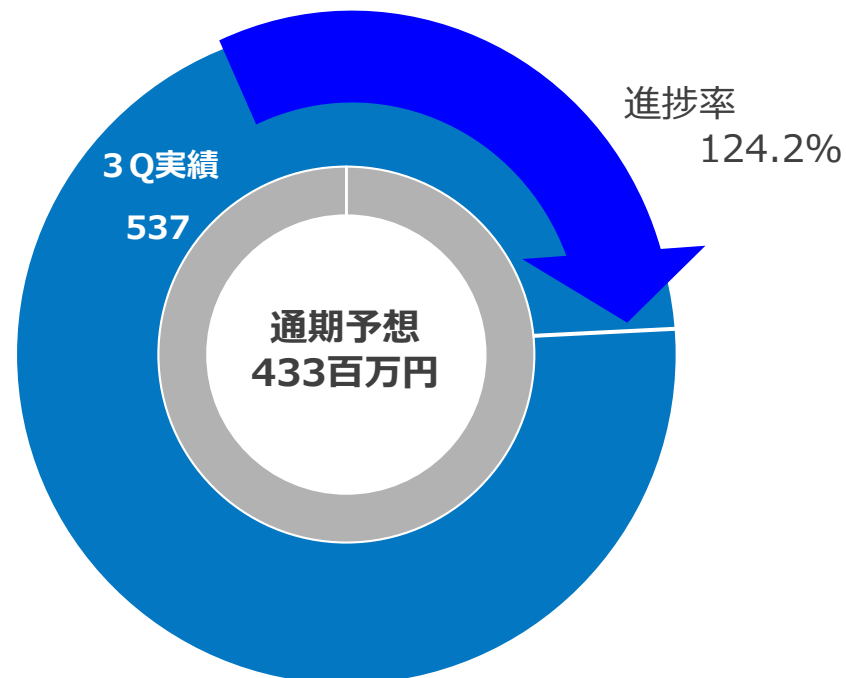
## 【売上高】

(単位：百万円)



## 【経常利益】

(単位：百万円)

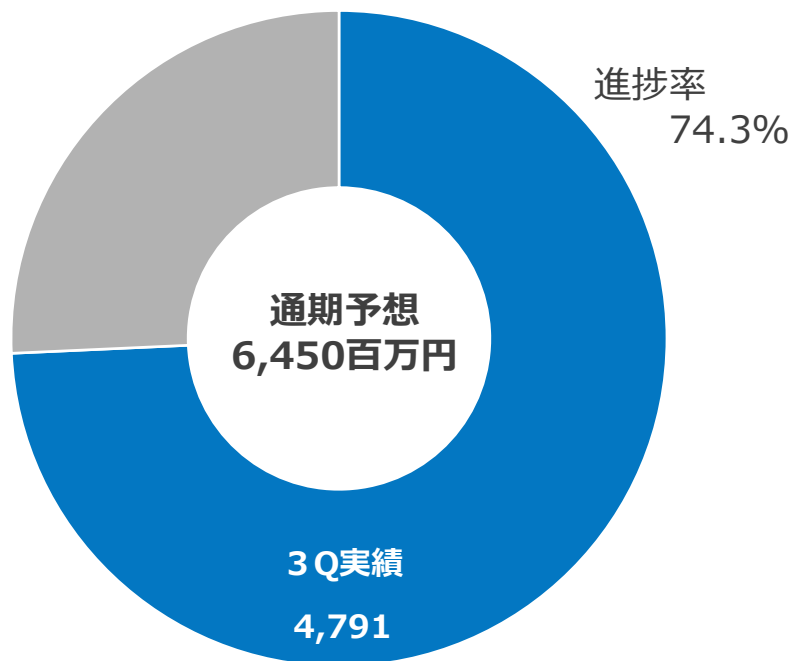


※ 3Qまでの実績は順調に推移。

通期修正予想に対する進捗率：売上高74.3% 経常利益89.7% 修正予想比でも順調な進捗。  
【参考】前期3Q時点の進捗率：売上高75.3% 経常利益98.6% 前期比においても順調。

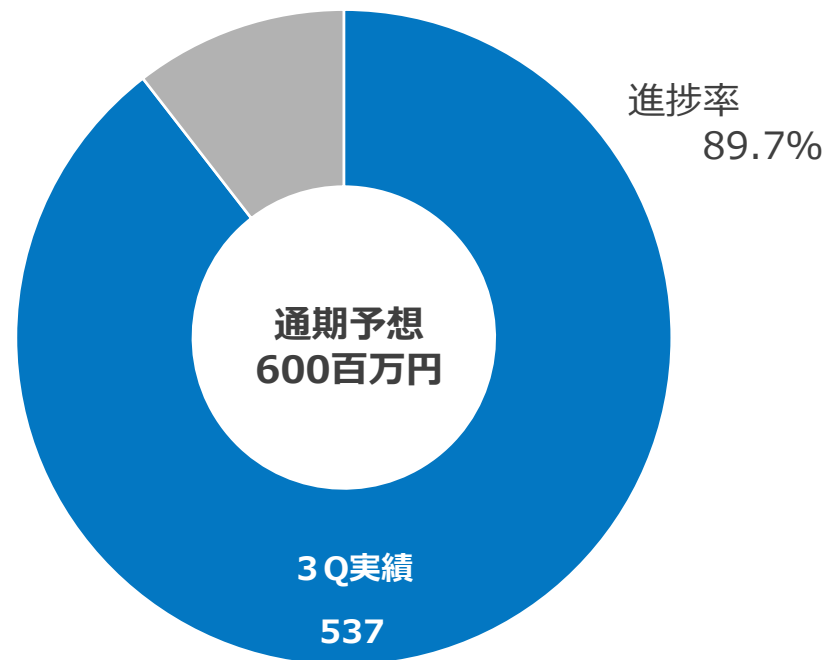
## 【売上高】

(単位：百万円)



## 【経常利益】

(単位：百万円)



※通期（修正）予想は、2/10上方修正後の数値。  
3Qまでの実績は順調に推移

## 進捗状況② 前年同期比（累計）

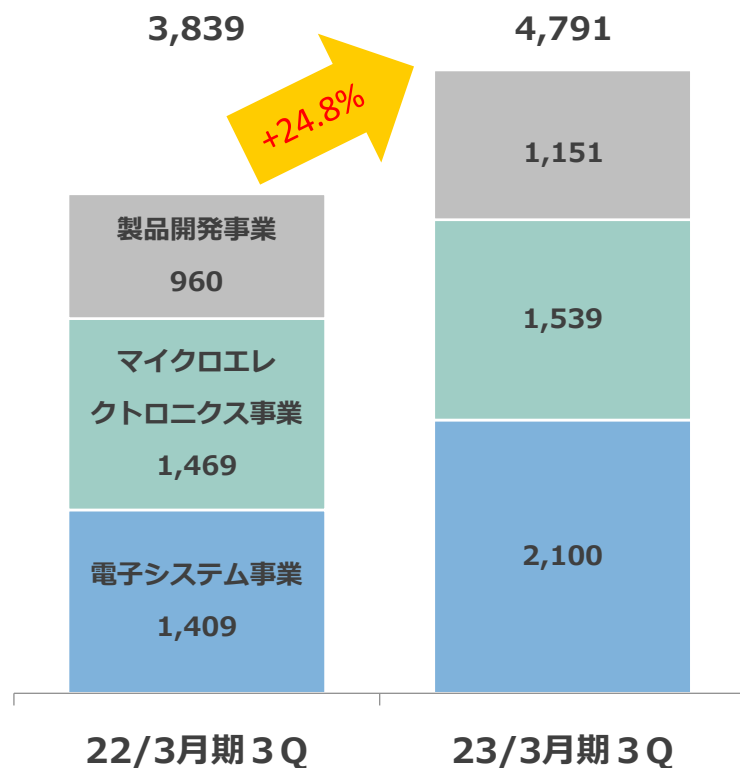
車載用半導体の生産増による後工程商材、カスタムバーンイン関連商材の受注が増加し電子システム事業が前期比+49.0%と大幅増収。

マイクロエレクトロニクス事業も半導体設計需要が堅調に推移。

製品開発事業も国内外におけるインフラ・産業機器市場でのカメラ需要が増加。

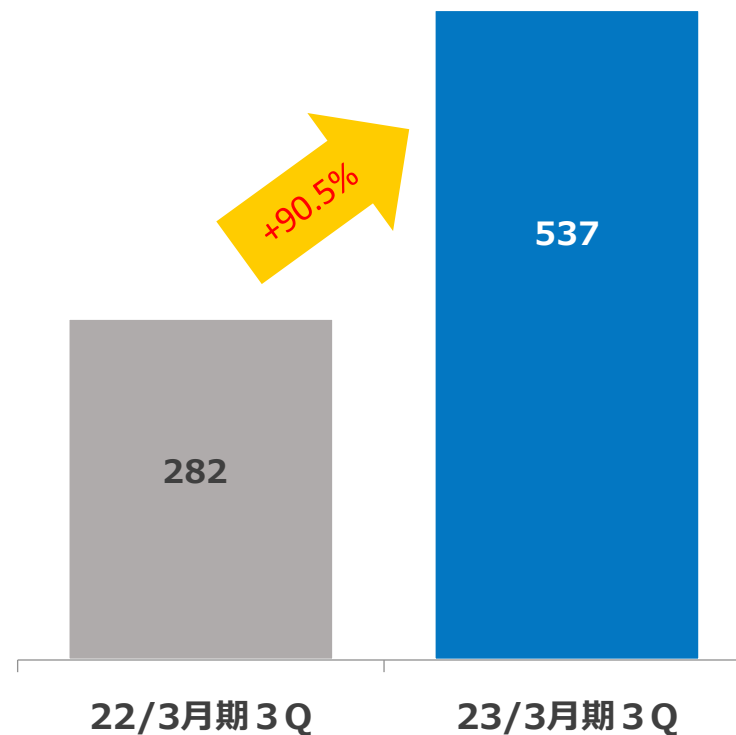
### 【売上高】

(単位：百万円)



### 【経常利益】

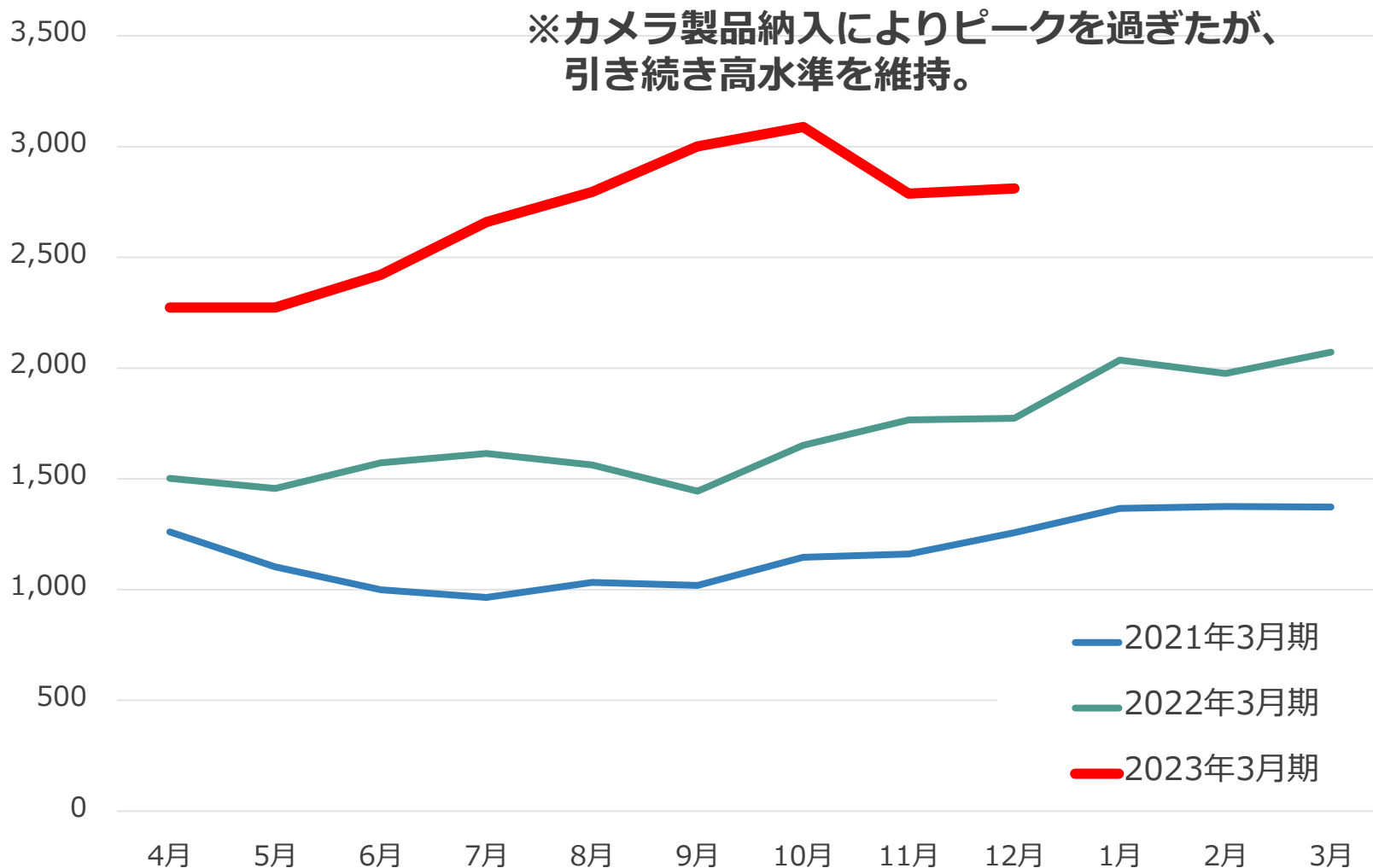
(単位：百万円)



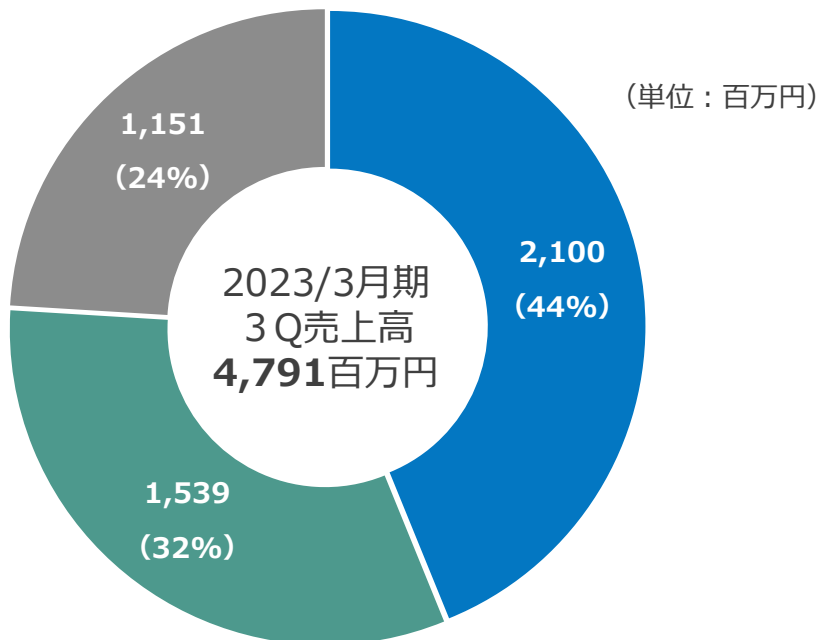
※売上高・経常利益とも前期比で増収増益。

## 【受注残高（全社）】

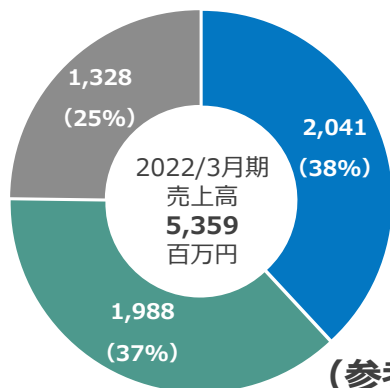
（単位：百万円）



事業別売上構成に大きな変化なし。  
電子システム事業の大幅増収により、同事業の構成比アップ。



23/3月期 3Q売上構成



(参考) 22/3月期売上構成

## 電子システム事業

### 半導体検査・装置関連

バーンイン装置、バーンイン装置レンタル、バーンインボード、半導体部品の検査ボード、半導体のテストプログラム、高速通信機器、各種電子機器検査用ボード、専用計測器、電子機器の開発・設計・製造

## マイクロエレクトロニクス事業

### LSI設計（アナログ・デジタル）、IPコア

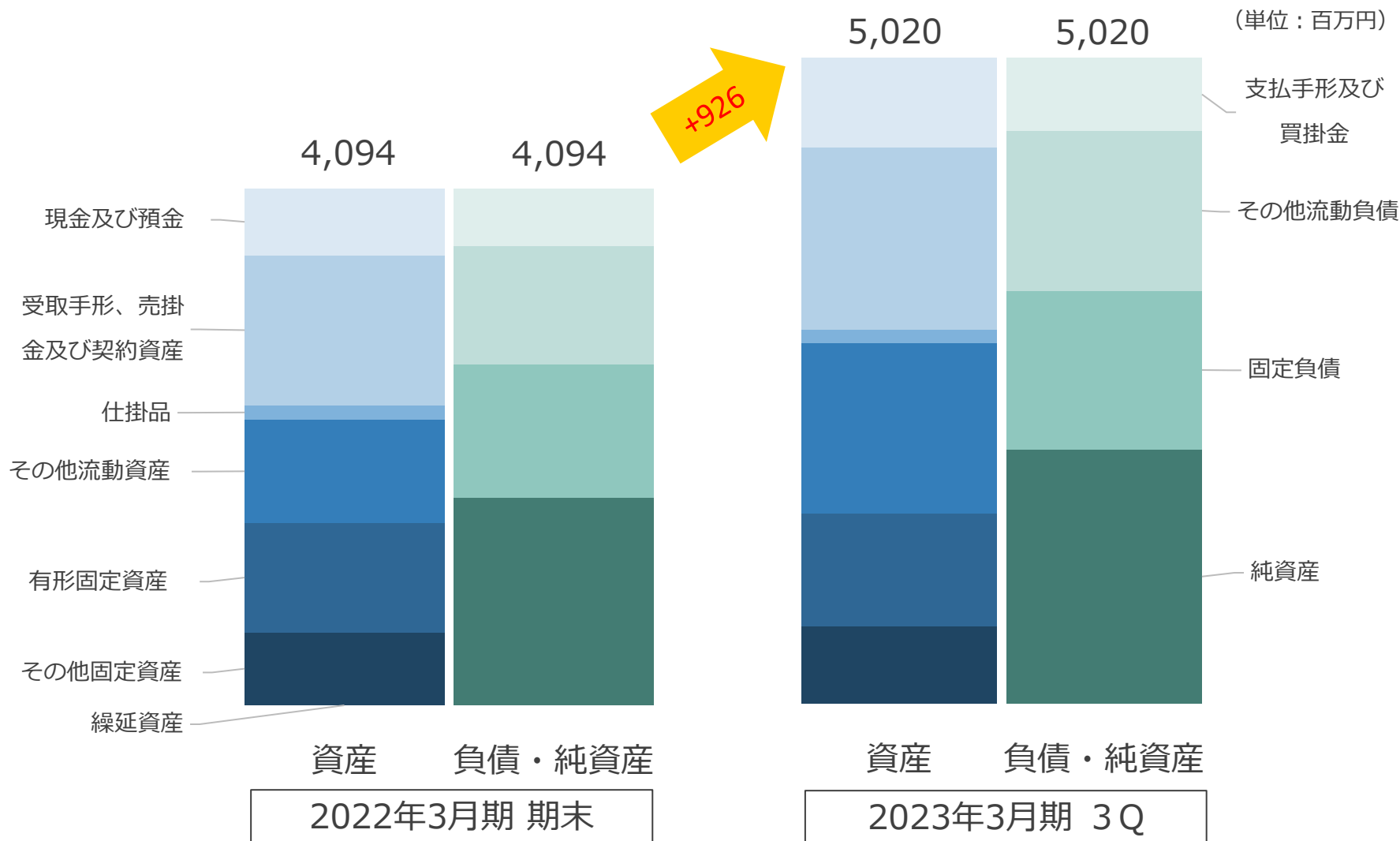
電源IC設計、高速I/F設計、イメージセンサ設計、画像処理系LSI設計、FPGA設計、ASIC設計、技術者派遣、JPEG、MIPI、ISP

## 製品開発事業

### 製品開発事業

画像関連機器、CMOSカメラモジュール、画像処理システム、画像処理モジュール

増収要因、部材の先行調達による流動資産が増加。  
 部材の先行調達のための短期借入金が増加など一時的に流動負債が増加。  
 着実な利益計上により、純資産も増加。





## 2022年

4月 1日 福岡デザインセンターを拡張

4月 4日 東京証券取引所 新市場区分変更より「スタンダード市場」に変更

5月13日 第50期 決算発表

画像処理のAI 応用に最適な画像処理半導体IPコアをリリース

5月24日 富山県魚津市に工場物件の取得を取締役会決議し、情報開示

6月 7日 3Dセンシングに先進的な技術を保有するMagikEye Inc.と資本業務提携

6月 9日 第50期 決算説明会

6月24日 第50期 定時株主総会

7月 1日 ルネサス エレクトロニクス株式会社「RZ パートナエコシステム」に加入

7月 7日 熊本県熊本市に新規事業所を設置・事業開始

8月31日 個人投資家向け会社説明会

10月26～28日 Japan IT Week秋 組込み/エッジコンピューティング展 出展 (in 幕張メッセ)

11月11日 2022年版 CSR報告書をリリース

11月15～18日 インテル® FPGAテクノロジー・デイ 2022 出展 (オンライン)

12月 6日 第51期 上期決算説明会

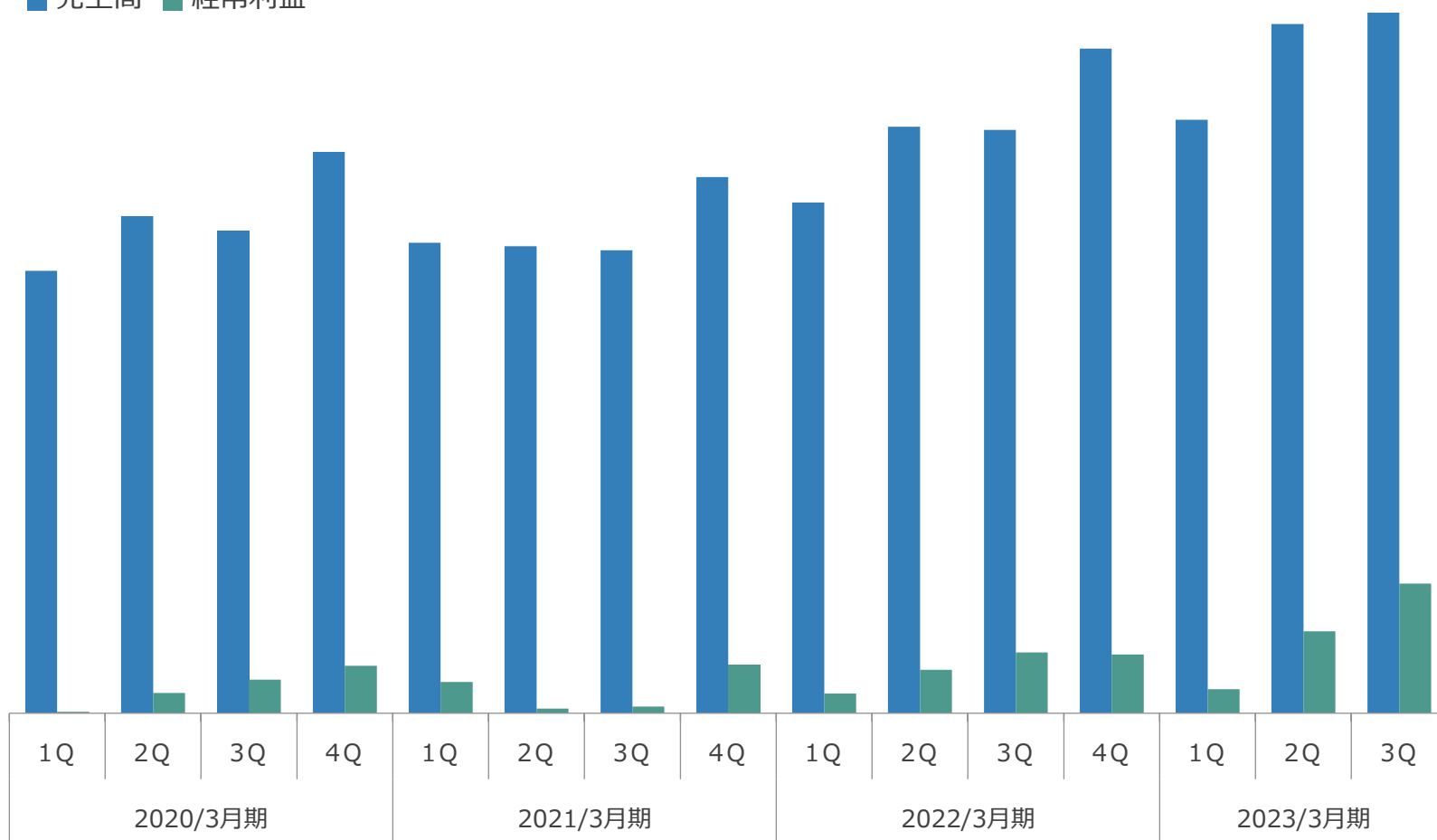
12月 7～9日 国際画像機器展2022 出展 (in パシフィコ横浜)

1Q

2Q

3Q

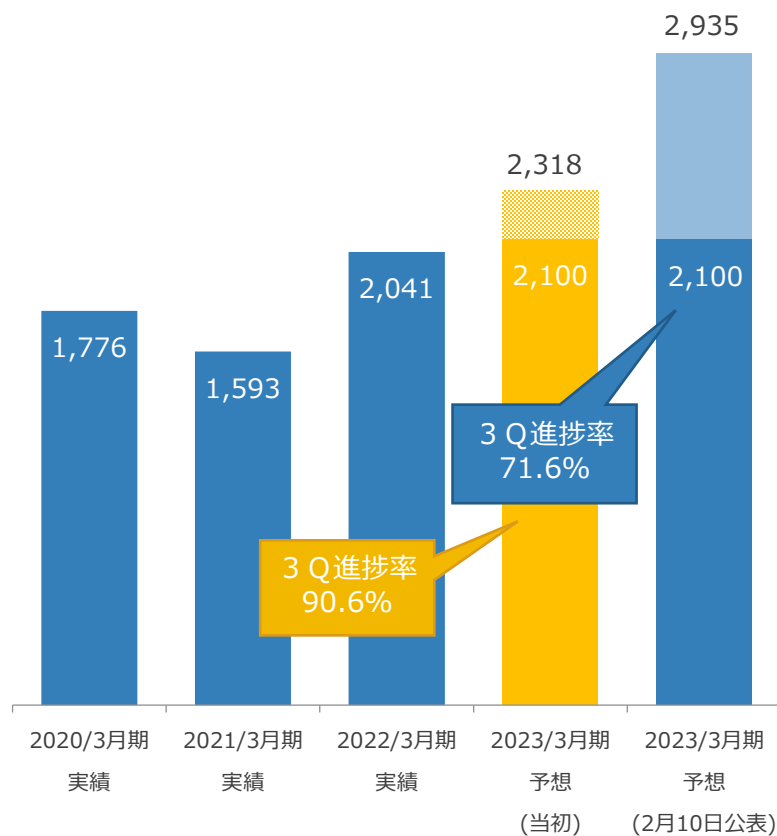
■ 売上高 ■ 経常利益



車載用半導体生産増による後工程商材の受注増、新製品用カスタムバーンイン商材の受注増が継続、車載製品用専用計測機器の受注が堅調。

## 【売上高】

(単位：百万円)

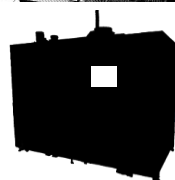


## 1~3Qトピックス

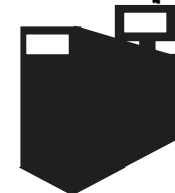
➤ 車載製品向けを中心に主要商材の受注好調継続



**バーンインボード**  
前期3Q比：196%



**半導体検査装置販売・リース**  
前期3Q比：161%



**車載製品用専用計測機器関連**  
前期3Q比：175%

➤ IoT PLC通信機器を展示会に出展

第13回 Japan IT Week秋

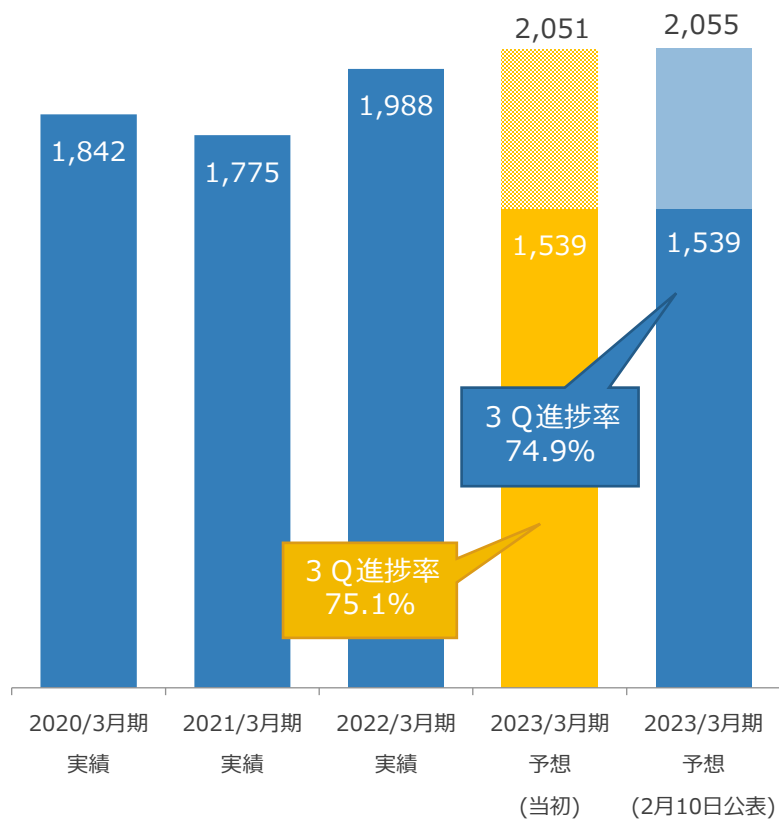
国際画像機器展2022



旺盛な半導体需要に支えられ、アナログはパワーデバイス、メモリや次世代通信関連、デジタルは画像処理関連のLSI設計、IP需要が堅調に推移。

## 【売上高】

(単位：百万円)



## 1~3Qトピックス

### ➤ アナログ半導体設計受託

パワー半導体関連  
前期3Q比：178%

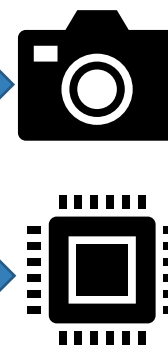
次世代通信関連  
前期3Q比：188%



### ➤ デジタル半導体設計受託

DSC向け画像処理関連  
前期3Q比：128%

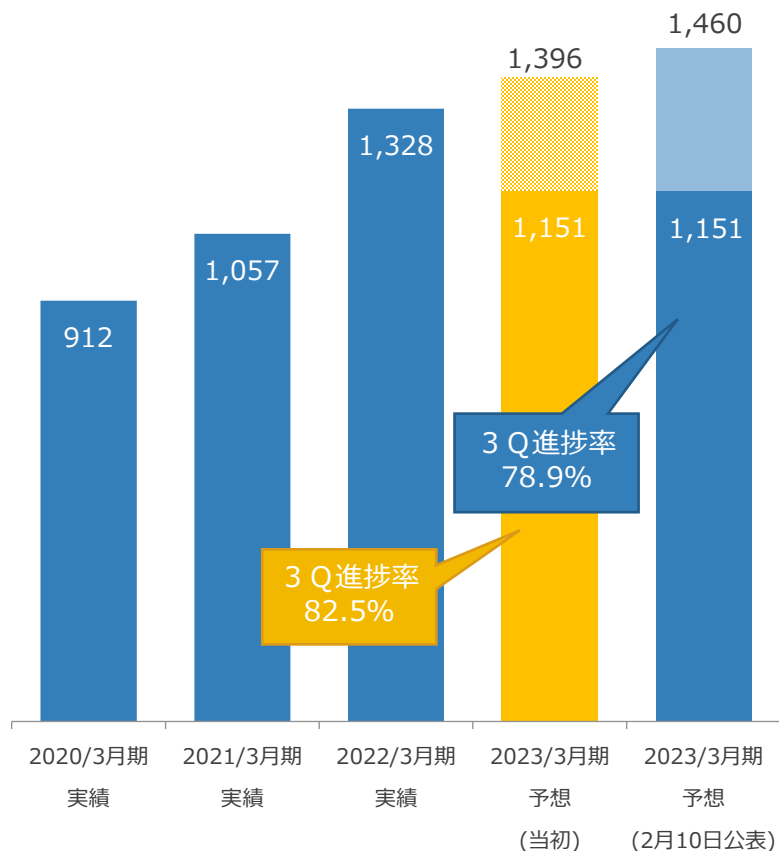
画像圧縮伸長-IP  
前期3Q比：137%



マイナンバーカード応用等、国内DX推進に伴うカメラ応用機器の出荷台数増加、及びASEAN・インド向け金銭機器の需要増に伴うビューカメラの出荷台数が大幅に増加。

## 【売上高】

（単位：百万円）



## 1~3Qトピックス

### 過去最高の製品出荷を実現

四半期で過去最高のカメラ出荷台数

前期3Q比：157%

内、社会インフラ向けビューカメラ出荷台数

前期3Q比：261%



120万画素USB出力カメラ

### 調達が多様化を目指し新たな商品を出荷

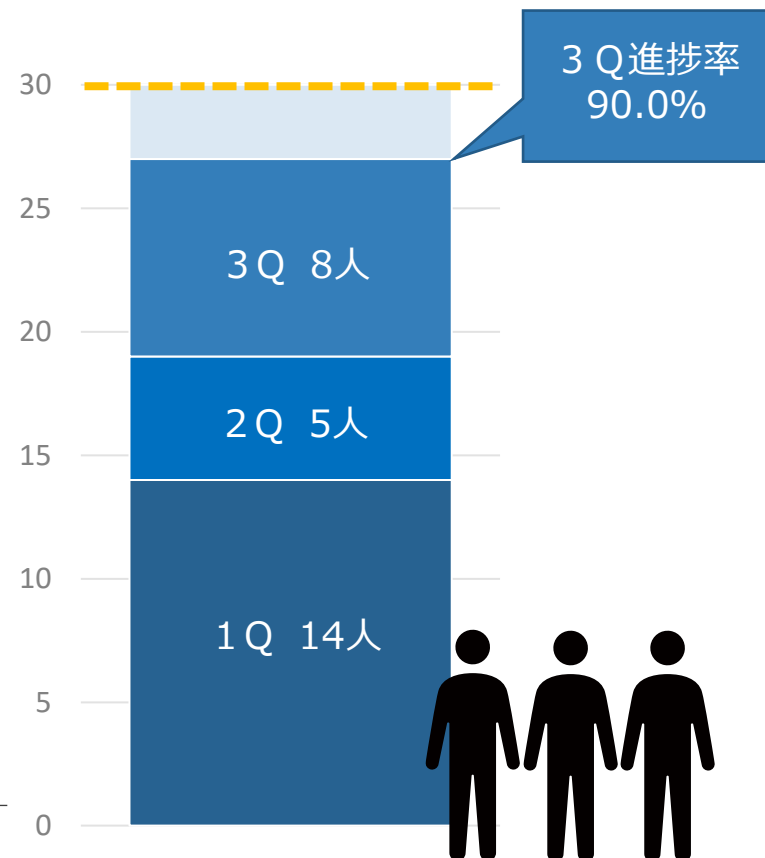
30万画素USB出力カメラ：S07VUE

10月量産出荷開始



- 好調な受注環境と成長に対応するため、人員増強を図っています。
- 通期で30人（技術：18人）の採用計画。3Qまで 27人（技術：11人）を採用。

人員  
通期採用計画：30人



研究開発の投下「工数」は、一部テーマの見直し・入替え実施により進捗率がやや低下。研究開発費での進捗に対する差分は、主に開発単価の予実差異によるものとなります。

## 主要開発テーマ

### 電子システム事業

- ・半導体検査装置・カスタム検査装置  
IoT-PLC通信モジュール

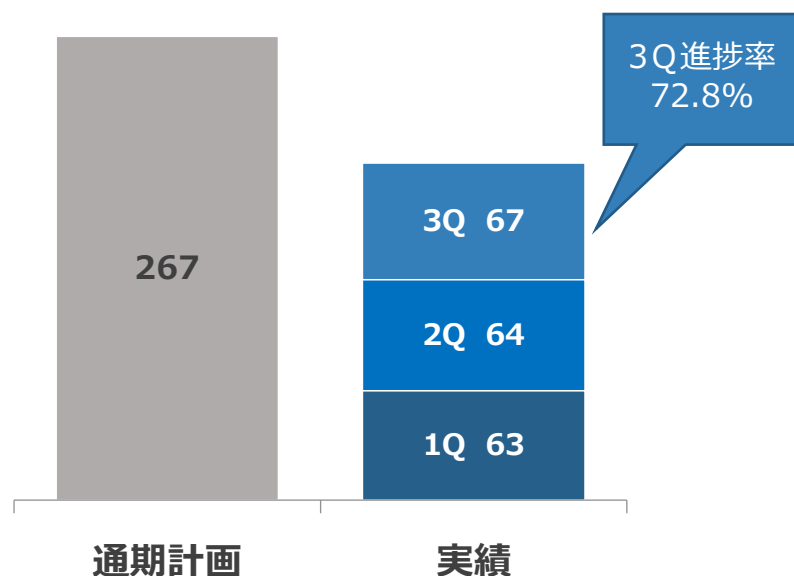
### マイクロエレクトロニクス事業

- ・JPEG IPコア・画像処理ISP IPコア

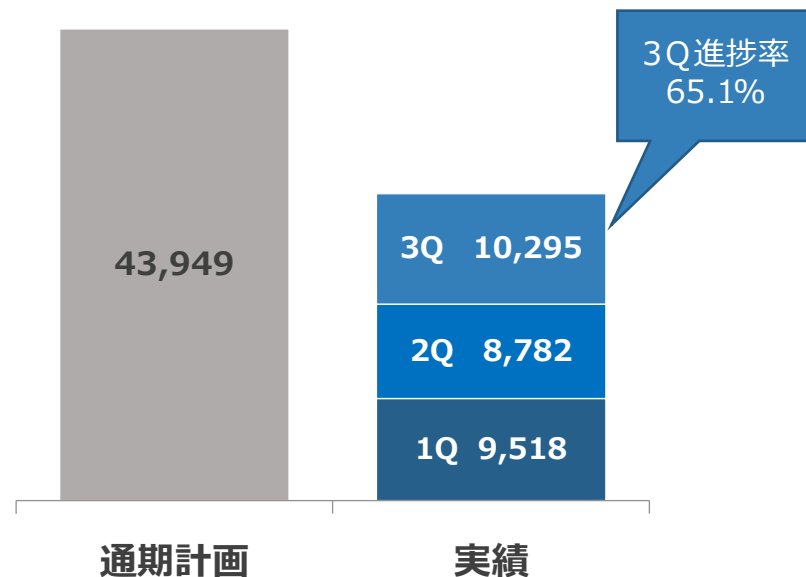
### 製品開発事業

- ・高画素/NWカメラ・3Dカメラ・介護向けシステム

【研究開発費】 (単位：百万円)



【研究開発工数】 (単位：H)



本資料で提供する情報のうち業績見通しおよび事業計画等に関するものは、当社が現時点で入手可能な情報と合理的であると判断する一定の前提に基づいており、リスクや不確実性を含んでおります。

従って、実際の業績は、様々な要因により、これらの見通しとは異なる結果になりうることをご承知おきください。

当社がこの資料を発行後、適用法令の要件に服する場合を除き、将来に関する記述を更新、又は修正して公表する義務を負うものではありません。

本資料に含まれる当社以外に関する情報は、公開情報等から引用したものであり、かかる情報の正確性、適切性等について当社は何らの検証も行っておらず、又これを保証するものではありません。

本資料の著作権は当社に帰属し、目的を問わず、当社に事前の承諾なく複製又は転用することなどを禁じます。

## ご注意事項

### 数字の処理について

当社業績に関する記載金額は特に明記が無い限り、以下の通り処理しております。そのため内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- ・表、グラフの金額：表示単位未満を切り捨て
- ・比率：表示単位第1位未満を四捨五入

## お問い合わせ先

株式会社シキノハイテック

常務取締役管理本部長 広田 文男

e-mail：IR-contact@shikino.co.jp

TEL：0765-22-3477 FAX：0765-22-3916

ホームページ：https://www.shikino.co.jp/